

技术数据表 Technical Data Sheet **DYG700-7A**

版本号: V01

1. 典型性能指标

测试项目	单位	典型值
环保或非环保	-	环保
外观	-	黑色
树脂类型	-	MAR+BP / MAR1
填料类型	-	球形
填料含量	%	88
填料最大尺寸	um	55/75
阻燃 UL-94	-	V-0
胶化时间	s	36
流动长度	inch	51
玻璃化转变温度 Tg	°C	123
热膨胀系数 1	ppm	8
热膨胀系数 2	ppm	32
弯曲强度@25℃	Мра	142
弯曲模量@25℃	Мра	24240
吸水率(PCT24h)	%	0.36
比重	g/cm3	2.00
导热系数	W/m.K	0.8
成型收缩率	%	0.18
体积电阻率@25℃	×10 ¹⁵ Ω.cm	5
电导率	μs/cm	33
рН	-	6.5
氯离子含量	ppm	12
钠离子含量	ppm	2

2. 成型及后固化条件

封装模具类型	单位	自动模
模塑温度	$^{\circ}$ C	170-190
模塑固化时间	sec	100-150
后固化温度	$^{\circ}$ C	175
后固化时间	h	4-8

3. 运输储存条件/有效期

= 1000000000000000000000000000000000000		
运输储存条件	5℃以下	
有效期	6 个月	

备注:以上数据基于上海道宜半导体材料有限公司实验室测试结果,非保证值,典型值仅供参考。

上海道宜半导体材料有限公司 DOITECH Semiconductor Advanced Material Co., Ltd中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正琅路 19 号 4 幢